

高精度自动焊线量测仪

WM-5200

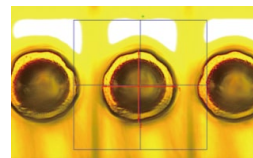
针对芯片焊线后所需诸元之量测而开发的自动高精度量测设备，可选配芯片固晶后产生的芯片偏移、倾斜等量测功能。

- 自动量测可避免人为量测的误差
- 统一量测定义规范
- 操作简单
- 执行程序下载，数据上传追踪方便
- 高重复精度
- 节省操作人力
- 报表格式名称自行定义

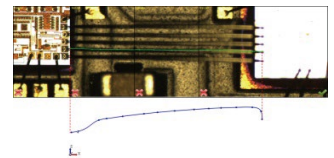


设备参数

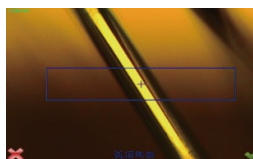
X / Y / Z 行程	X轴	350mm
	Y轴	300mm
	Z轴	150mm
	金属台尺寸	570X470mm ²
驱动控制系统		独立伺服器马达控制
X / Y / Z 轴光学尺分辨率		X / Y = 0.5μm , Z = 0.1μm
X / Y / Z 重复量测精度		X / Y < 1μm , Z < 0.5μm
X / Y / Z 量测误差值		X / Y < ±1μm , Z < ±0.5μm
X / Y 坐标标示误差		≲ (2+L/100)
影像系统		<ul style="list-style-type: none"> ● 摄像CCD：彩色 1/2 CCD ● 物镜：日系高分辨镜头 ● 物镜倍率：5X、20X、50X ● 视频倍率：136X - 1367X ● 物方视野：0.12 - 1.27mm
量测软件		QC3000
光源		LED
外型尺寸		1200X1300X1820 (不含指示灯)
仪器重量		750kg - 900kg
光学系统		日制高阶光学镜组
工作电压		220V (单向)



球大小
(Ball Size X,Y,Z)



线弧长
(Wire Length)



弧高
(Loop Height)



多芯片
(MCP, Stack Dies)

选配项目

- SECS 功能
- Load / Unload 功能
- 2D Reader
- Diebond Measurement

高精度多功能量测仪

MFM-3500 Series

产品特点

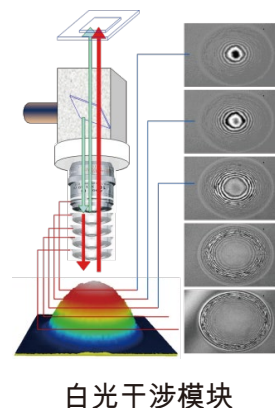
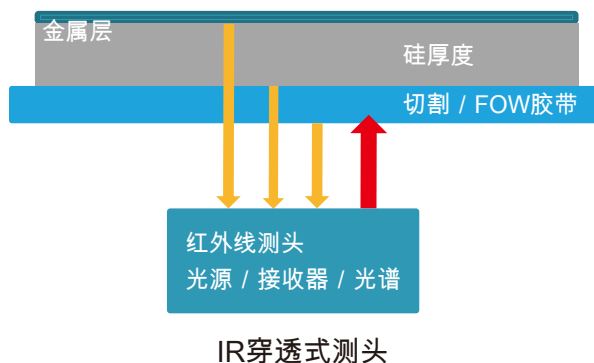
- 操作流程简易，降低教育训练成本
- 人工放置待测物，机台自动化跑位、量测与报表输出
- 多孔陶瓷吸盘完整吸附待测物
- 花岗岩底座搭配气浮式防震桌，有效隔离高频振动，将机身振动影响降至最低
- 高精度移动马达
- 针对无尘室环境设计的防尘外罩
- 连线管理SECS / GEM (选配)

光学检测

- 高速 / 无接触光学量测
- 非透明材质 / 透明材质形貌分析
- 多层膜厚度量测



解析能力 = 0.1 μ m	<ol style="list-style-type: none">1. 排除线性厚度误差$20\pm 1C$，重复性$< \pm 0.5\mu$m2. 当环境控制（振动）良好时，其粗糙度$Rz < 0.1\mu$m，重复性$\pm 0.3\mu$m3. 以上重复性为1σ
精度	<ol style="list-style-type: none">1. 单层厚度精度2. 包含线性厚度误差单层厚度 $> 50\mu$m : $< \pm 0.01 \times$ 测量结果3. 单层厚度 $\leq 50\mu$m : $\pm 0.5\mu$m4. 以上重复性 = 1σ ($\pm 0.5 \mu$m)



Contact us

上海市浦东新区祖冲之路1077号2幢3201室
+86 (21) 6108 1858 #3121
marketing@spirox.com

